DIVA Labs.

ECR (Engineering Change Request)

Proposed Change：	☐1. Design modification 設計修改 ☐2. Material change 材料變更 ☐3. Manufacturer change 製造商變更 ☐4. Factory change 工廠變更 ☐5. Process sequency change 工序變更 ☐6. Equipment / Tooling change 設備/ 模具變更 ☐7. Process / Method / Condition change 加工流程/方法/條件變更 ■8.Add second source 新增替代料 ☐9. Others 其他：_____	**Initiator** ： Kevin Tan 07/1 1505
Reason for Change：	Due to Nexperial stop shipping 3D12VL2BT1Y issue , add second source.	**EC No**：EC26010501
Model / Part No.：	Please refer to the attached file	**Issue Date**： 2026/1/2
		Requester Dept.：DVIIM016
Implementation Type：	☐1. Immediately Change 立即切換 ■2. Running Change 自然切換 ☐3. Other 其他：_____	**Customer Approval**：☐Needed (confirmed by PM) ■Not needed

Material Change Description（Please add pages as needed if the provided space is insufficient.）
物料變更說明（如不敷使用請逕行增頁）

No.	Subassembly		Part No.	Description	Q'ty	Location	Stock	Remark
1	2AAD137R03C	B						1st: 3D12VL2BT1Y 2nd: 3D12VL2BT2Y
		A	3D12VL2BT2Y	ESD (DESD12VL2BTQ,SOT-23,DIODES)	1	D2	O	
2	2AAD137R03C181	B						1st: 3D12VL2BT1Y 2nd: 3D12VL2BT2Y
		A	3D12VL2BT2Y	ESD (DESD12VL2BTQ,SOT-23,DIODES)	1	D2	O	
3	2AAD616014S	B						1st: 3D12VL2BT1Y 2nd: 3D12VL2BT2Y
		A	3D12VL2BT2Y	ESD (DESD12VL2BTQ,SOT-23,DIODES)	2	D11,D12	O	

Comments 會簽意見

Canvys機種不執行、內部EL繼續執行 Kevin Tan 07/1 1100

R&D		Department 會簽部門								Approval
Initiator	Initiator's Direct Supervisor	DQE	PM	Sales	PE	PMC	SCM	PD	QA	R&D Director
Kevin Tan 0106 1700	Michael 0106 1740	0107 1320	0107	0107 1045	0112 1315	Terry 0112 1700	0112	0112 1830	0113	Michael 0127 1500

ECR (Engineering Change Request)

Engineering Change Assessment Item List 工程變更評估項目清單			
Document	Confirm	Authorized Dept.	Remark
1. Application for Revision of Specification or Drawing(s) for delivery 是否有修改交貨的規格或圖面	☐Yes ■No need	RD	無影響
2. Standards or Regulatories Impact 是否有評估適用之標準或主管機關之相關法規的申請	☐Yes ☑No need	DQE	無影响
3. Change point of PCB mounting PCBA插件位置是否變更	☐Yes ■No need	RD	無影響
4. PCBA Process Changes PCBA製程是否變更	☐Yes (Continue checking below) ☑No	PE	無影响
4-1) Change of Reflow temperature 迴焊溫度是否變更	☐Yes ☐No need		
4-2) Change of bonding temperature 膠合溫度是否變更	☐Yes ☐No need		
4-3) Change of Manual Soldering temperature 人工手焊工具之溫度是否變更	☐Yes ☐No need		
4-4) Change of storage condition after protection humidity package 防潮包裝完成後的儲存條件是否變更	☐Yes ☐No need		
5. Reliability test report (Test result and data) 是否有可靠性測試報告（測試結果及數據）	☐Yes ☑No need	DQE	無影响
6. Process FMEA（Medical only） 是否有進行製程失效模式與效應分析	☐Yes ☑No need	PE	無影响
7. Design FMEA（Medical only） 是否有進行設計失效模式與效應分析	☐Yes ■No need	RD	無影響
8. Risk Management（Medical only） 是否有進行風險管理評估	☐Yes ■No need	RD	無影響
9. Change points due to the modification 是否此修改會延伸導致其他變更點	☐Yes ■No need	RD	無影響

ECR (Engineering Change Request)

Engineering Change Assessment Item List 工程變更評估項目清單			
Document	Confirm	Authorized Dept.	Remark
10. Initial Supply Control implements plan or result. 是否有實施供料控制評估	☑Yes ☐No need	PMC	
10-1) Confirm the work order or order number or date for the implementation start of the engineering change. 確認工程變更開始實施之工單或訂單號碼或日期。	☐Yes ☑No need		
10-2) Coordinate the handling methods for related products and materials. 協調相關產品及材料處理方法。	☐Yes ☑No need		
10-3) Arrange the production schedule. 處理生產日程之安排。	☐Yes ☑No need		
10-4) Control the changed materials. 變更材料之管制。	☑Yes ☐No need		舊料3D printer打下設計
10-5) Establish relevant execution control records for EC materials, register traceability data for each material. 建立有關工程變更物料之相關執行管控記錄、登錄各項物料追溯性資料。	☑Yes ☐No need		
11. Training Requirement 若此一變更影響製程或檢驗，是否需要再做人員訓練	☐Yes ☑No need	PE	無影響
12. Modification contents (For example, the following documents) 是否有評估此變更之各項相關文件（如下） ☐ MDF ☐ DMR ☐ SOP ☐ SIP ☐ QC control plan ☐ Approval Sheet ☐ Engineering Spec ☐ Others	☐Yes ☑No need	QA	SOP無影响

影響機種

母件	母件物料說明	子件	客戶簡稱	內銷-業務代表	外銷-業務代表
1A1A2432Y105100	TSI24PDABVAZZZZ	3D12VL2BT1`	TSI		Oliver Chen
1A1A2132Y105100	TSI21PDAAVAZZZZ	3D12VL2BT1`	TSI		Oliver Chen
1A1A2123Y321801	DT2162M-P	3D12VL2BT1`	建碁	Oliver Chen	Oliver Chen
1A1A2123Y321800	DT2162M	3D12VL2BT1`	建碁	Oliver Chen	Oliver Chen
1A1A2423Y321800	DT2462M-P V2	3D12VL2BT1`	建碁	Oliver Chen	Oliver Chen
1A1A2323Y310500	RGP2462AMII-PW(AG) C	3D12VL2BT1`	DIVA CHINA	Oliver Chen	Oliver Chen
1A2A2423Y224200	RIC2462A-P v2	3D12VL2BT1`	RESTAR		Oliver Chen
1A1A2723S205100	TSI27PDADVAZZZZ	3D12VL2BT1`	TSI		Oliver Chen
1A1A2123Y312400	RGP2162AMII-PB(AG)	3D12VL2BT1`	GE INDIA		Oliver Chen
1A1A2423Y321801	DT2462M-P(US)	3D12VL2BT1`	建碁	Oliver Chen	Oliver Chen
1A1A2132Y105101	TSI21PDAAVAZZZZ	3D12VL2BT1`	TSI		Oliver Chen
1A2A1923P310700	RGP1933AMII	3D12VL2BT1`	GE HEALTH		Jessie Ye 葉玲希
1A2A1923P310701	RGP1933AMII DRU	3D12VL2BT1`	GE HEALTH		Jessie Ye 葉玲希
1A1A1823E215500	RGP1823AM	3D12VL2BT1`	PHILIPS IN		Estela Hu 胡靜文
1A1A2123Y308902	ST-21512-TP v2	3D12VL2BT1`	LINDEN GR(	Estela Hu 胡靜文	Estela Hu 胡靜文
1A1A2123Y308903	ST-21612-TP v2	3D12VL2BT1`	LINDEN GR(	Estela Hu 胡靜文	Estela Hu 胡靜文
1A1A2323Y308902	ST-24512-TP(YD) v2	3D12VL2BT1`	LINDEN GR(	Estela Hu 胡靜文	Estela Hu 胡靜文
1A1A2323Y308903	ST-24612-TP(YD) v2	3D12VL2BT1`	LINDEN GR(	Estela Hu 胡靜文	Estela Hu 胡靜文
1A2A1816E203201	PC180380R	3D12VL2BT1`	PIXELINK		Dennis Liu 劉証瑋
1A2A1823E203200	PC180380R RGP	3D12VL2BT1`	PIXELINK		Dennis Liu 劉証瑋
1A2A1816E203200	PC180380R	3D12VL2BT1`	PIXELINK		Dennis Liu 劉証瑋
1A3A1527Y203200	LKA15XESZCD-DA1	3D12VL2BT1`	PIXELINK		Dennis Liu 劉証瑋
1A2A1528Y700800	VLD15906PCAP	3D12VL2BT1`	OLORINAB		Dennis Liu 劉証瑋
1A1A2123Y304201	22127 v2	3D12VL2BT1`	CONTEC		Dennis Liu 劉証瑋
1A2A2723S303200	PC270434R(RGD2773AMII-P)	3D12VL2BT1`	PIXELINK		Dennis Liu 劉証瑋
1A1A1923E203200	PC190465R RGD	3D12VL2BT1`	PIXELINK		Dennis Liu 劉証瑋
1A1A2323Y100001	RGD2461AMI-PW(AG)	3D12VL2BT1`	DIVA標準品		
1A1A2432Y100000	QD2461AI-PB(AG)	3D12VL2BT1`	DIVA標準品		
1A1A2323Y100002	RGD2461AMI-PW(AG)	3D12VL2BT1`	DIVA標準品		
1A1A2123Y200000	RGD2161A-PW(CLR)	3D12VL2BT1`	DIVA標準品		
1A1A2123Y300000	RGP2162AMII-PW(AG)	3D12VL2BT1`	DIVA標準品		
1A1A2123Y300001	RGP2162AMII-PB(AG)	3D12VL2BT1`	DIVA標準品		
1A1A2123Y300002	RGD2162AMII-PW(AG)	3D12VL2BT1`	DIVA標準品		
1A1A2132Y100000	QD2161AI-PB(AG)	3D12VL2BT1`	DIVA標準品		

Estela
0108
1030

0103
1105

DIVA Labs.

ECR (Engineering Change Request)

Proposed Change：
☐1. Design modification 設計修改 ☐2. Material change 材料變更 ☐3. Manufacturer change 製造商變更
☐4. Factory change 工廠變更 ☐5. Process sequency change 工序變更 ☐6. Equipment / Tooling change 設備/ 模具變更
☐7. Process / Method / Condition change 加工流程/方法/條件變更 ■8.Add second source 新增替代料
☐9. Others 其他：_____

Initiator ： X

Reason for Change： Due to Nexperial stop shipping 3D12VL2BT1Y issue , add second source.

EC No ： EC26010701

Model / Part No. ： DCA21E08721DIHB, DCA21E08721DIHO, LCRA21EAGBC-BI2, MDRAD21ELXAC-A2
MDRAP18EAXAD-W1, MDRAP18EAXAD-W1_RGP, MDRO19XADBD-BLC

Issue Date ： 2026/1/2

Requester Dept. ： DV11M016

Implementation Type ： ☐1. Immediately Change 立即切換 ▨2. Running Change 自然切換 ☐3. Other 其他：_____

Customer Approval ： ■Needed ☐Not needed
（confirmed by PM）

Material Change Description（Please add pages as needed if the provided space is insufficient.）
物料變更說明（如不敷使用請逕行增頁）

No.	Subassembly		Part No.	Description	Q'ty	Location	Stock	Remark
1	2AAD137R03C	B						1st: 3D12VL2BT1Y 2nd: 3D12VL2BT2Y
		A	3D12VL2BT2Y	ESD (DESD12VL2BTQ,SOT-23,DIODES)	1	D2	6	
2	2AAD291R03C	B						1st: 3D12VL2BT1Y 2nd: 3D12VL2BT2Y
		A	3D12VL2BT2Y	ESD (DESD12VL2BTQ,SOT-23,DIODES)	1	D2	6	
		B						
		A						

Comments 會簽意見

加種ECL，此份EC作廢 KevinTan 01/21 11:00

作廢 Momo 2026.2.4

R&D		Department 會簽部門								Approval
Initiator	Initiator's Direct Supervisor	DQE	PM	Sales	PE	PMC	SCM	PD	QA	R&D Director
KevinTan 01/06	Michael 01/05 11:55 Jolyn 01/06 14:00	01/07 10:20	01/07 10:55	01/07 11:05	01/12 13:15 Vivian 01/12 10:03	Terry 01/16 11:00	Miki 1/26	01/12 13:30 Joanne 01/12 15:30	01/27	X

ECR (Engineering Change Request)

Engineering Change Assessment Item List 工程變更評估項目清單			
Document	Confirm	Authorized Dept.	Remark
1. Application for Revision of Specification or Drawing(s) for delivery 是否有修改交貨的規格或圖面	☐Yes ■No need	RD	無影響
2. Standards or Regulatories Impact 是否有評估適用之標準或主管機關之相關法規的申請	☐Yes ☑No need	DQE	無影響
3. Change point of PCB mounting PCBA插件位置是否變更	☐Yes ■No need	RD	無影響
4. PCBA Process Changes PCBA製程是否變更	☐Yes (Continue checking below) ☑No	PE	無影響
4-1) Change of Reflow temperature 迴焊溫度是否變更	☐Yes ☐No need		
4-2) Change of bonding temperature 膠合溫度是否變更	☐Yes ☐No need		
4-3) Change of Manual Soldering temperature 人工手焊工具之溫度是否變更	☐Yes ☐No need		
4-4) Change of storage condition after protection humidity package 防潮包裝完成後的儲存條件是否變更	☐Yes ☐No need		
5. Reliability test report (Test result and data) 是否有可靠性測試報告（測試結果及數據）	☐Yes ☑No need	DQE	無影響
6. Process FMEA（Medical only） 是否有進行製程失效模式與效應分析	☐Yes ☑No need	PE	無影響
7. Design FMEA （Medical only） 是否有進行設計失效模式與效應分析	☐Yes ■No need	RD	無影響
8. Risk Management（Medical only） 是否有進行風險管理評估	☐Yes ■No need	RD	無影響
9. Change points due to the modification 是否此修改會延伸導致其他變更點	☐Yes ■No need	RD	無影響

ECR (Engineering Change Request)

Engineering Change Assessment Item List
工程變更評估項目清單

Document	Confirm	Authorized Dept.	Remark
10. Initial Supply Control implements plan or result. 是否有實施供料控制評估	☑Yes ☐No need	PMC	
10-1) Confirm the work order or order number or date for the implementation start of the engineering change. 確認工程變更開始實施之工單或訂單號碼或日期。	☐Yes ☑No need		
10-2) Coordinate the handling methods for related products and materials. 協調相關產品及材料處理方法。	☐Yes ☑No need		
10-3) Arrange the production schedule. 處理生產日程之安排。	☐Yes ☑No need		
10-4) Control the changed materials. 變更材料之管制。	☑Yes ☐No need		舊料3D/3VL>BT1下殼36
10-5) Establish relevant execution control records for EC materials, register traceability data for each material. 建立有關工程變更物料之相關執行管控記錄、登錄各項物料追溯性資料。	☑Yes ☐No need		
11. Training Requirement 若此一變更影響製程或檢驗，是否需要再做人員訓練	☐Yes ☑No need	PE	無影响
12. Modification contents (For example, the following documents) 是否有評估此變更之各項相關文件（如下） ☐ MDF ☐ DMR ☐ SOP ☐ SIP ☐ QC control plan ☐ Approval Sheet ☐ Engineering Spec ☐ Others	☐Yes ☑No need	QA	5W無影响

DIVA Labs.

Supplier Change Request (SCR)

Proposed Change： ☐1. Design modification 設計修改 ☐2. Material change 材料變更 ☐3. Manufacturer change 製造商變更 ☐4. Factory change 工廠變更 ☐5. Process sequency change 工序變更 ☐6. Equipment / Tooling change 設備/模具變更 ☐7. Process / Method / Condition change 加工流程/方法/條件變更 ■8.Add second source 新增替代料 ☐9. Others 其他：_____	**Change No：** EC26010701
	Date： 2026/1/29
Reason for Change： Due to Nexperial stop shipping 3D12VL2BT1Y issue , add second source.	
Model / Part No.： DCA21E08721DIHB, DCA21E08721DIHO, LCRA21EAGBC-BI2, MDRAD21ELXAC-A2 MDRAP18EAXAD-W1, MDRAP18EAXAD-W1_RGP, MDRO19XADBD-BLC	
Implementation Type： ☐1. Immediately Change 立即切換 ■2. Running Change 自然切換 ☐3. Other 其他：_____	

Material Change Description（Please add pages as needed if the provided space is insufficient.）
物料變更說明（如不敷使用請逕行增頁）

No.	Subassembly		Part No.	Description	Q'ty	Location	Stock	Remark
1	2AAD137R03C	B						1st: 3D12VL2BT1Y 2nd: 3D12VL2BT2Y
		A	3D12VL2BT2Y	ESD (DESD12VL2BTQ,SOT-23,DIODES)	1	D2		
2	2AAD291R03C	B						1st: 3D12VL2BT1Y 2nd: 3D12VL2BT2Y
		A	3D12VL2BT2Y	ESD (DESD12VL2BTQ,SOT-23,DIODES)	1	D2		
		B						
		A						

Comments

此份作廢，如附件Mail說明。 Mmo 2026.1.29

DIVA Representative			Customer Approval
Engineering	**PM**	**Sales**	
Kevin Tan 01/29 15:30	01/30 14:59	01/30 15:30	

Kevin_Tan

寄件者: Dennis <Dennis_liu@diva.com.tw>
寄件日期: 2026年7月20日星期一 下午 3:39
收件者: 'hsuan_wang'; 'Amber_Tsao曹嘉雯'; 'Asli_Cheng 鄭正宜'; 'Daniel_Huang 黃國哲'; 'Eric_Chang張鈞凱'; 'Estela_Hu胡靜文'; 'Jacky_Lu盧俊宇'; 'Joan_Wang王尹珏'; 'joe_lin 林雪清'; 'Kent_Hsieh謝冠彰'; 'Kevin_Chen 陳冠宇'; 'Kevin_Lee 李金龍'; 'Laslie_Chen陳志偉'; 'Lily_Chiu邱羽萱'; 'Michael_Young 楊建勛'; 'Momo_Hsiao蕭玉桃'; 'Morris_Pan潘介翰'; 'Nick_Lin 林益銓'; 'Oliver_Chen陳冠華'; 'Rex_Wang王寶源'; 'Rice_Lee 李金隆'; 'Rongchi_Liao廖榮棋'; 'Ryan_Wang 王志維'; 'Sharon_Yeh 葉文琴'; 'Siang_Hsu許吉翔'; 'Terry_Huang 黃振哲'; 'Tina_Chen 陳美玉'; 'Tyson_Chen陳泰盛'; 'John_Tsai蔡博翔'; han_lee@diva.com.tw
主旨: RE: ECR客戶回覆追蹤表_20260720
附件: [0427]ECR會議紀錄 (5.70 MB)

Dear Hsuan,

如同所提, 現在Canvys有待簽的兩份ECR回覆如下

EC26010501: 使用3BBT390420Y的RAP機種皆已EOL, 無2485 Scaler IC, 再請幫忙結案或撤回

EC26010701: 3D12VL2BT1Y現僅有MDRAP18EAXAD-W1_RGP會使用到, 年用量約300 pcs, MDRO19XADBD-BLC僅出過兩台樣品無量產, 其他機種皆EOL, 4月份的ECR會議結論是現貨還找得到料, 先不導入, 請結案

EC		客戶	導入機種	
EC No. :	完成日			
EC26010501	2025/12/31	Canvys	1A1A2116E100100 _LCRAP21EAGBABST / 1A1A2116E300100 _MDRAP21EAGBCBIU / 1A1A2116E300102 _MDRAP21EAXACBIU-KO / 1A2A1816E200100 _MDRAP18EAXAD-W1 / 1A2A2116E300101 _MDRAP21EAXACRW1 / 1A2G2116E300101 _MDRAD21ELXAC-A2 / 1A3C1516H200100_MDLFM154-W3ODBU	Due t 3BBT3904 Add 2nd 3BBT3904
EC26010701	2026/1/2	Canvys	1A2A1823E200100 _MDRAP18EAXAD-W1_RGP / 1A2A1927P200100 _MDRO19XADBD-BLC / 1A2G2116E300101 _MDRAD21ELXAC-A2 / 1A2A1816E200100 _MDRAP18EAXAD-W1 / 1A2A2116E300105 _DCA21E08721DIHB / 1A2A2116E300107 _LCRA21EAGBC-BI2 / 1A2A2116E300106 _DCA21E08721DIHO	Due t 3D12VL2B Add 3D12VL2BT2Y (

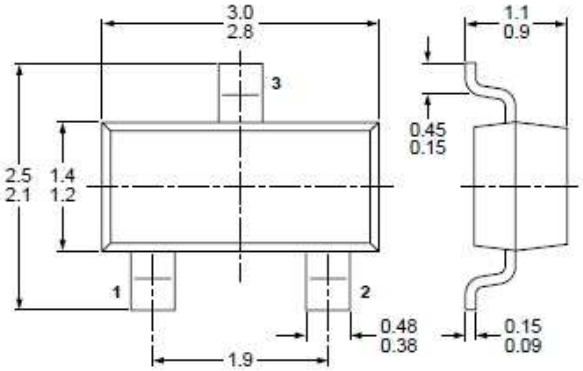
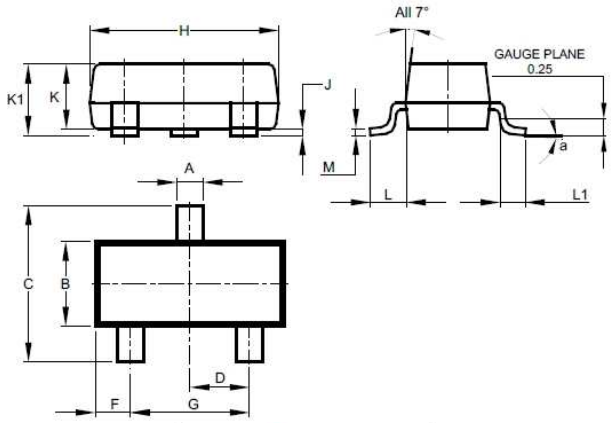
Thanks & Best Regards
Dennis Liu

DIVA Laboratories, Ltd. | Sales & Marketing Dep.
T:+886-2-2226-8631#245 | E: dennis_liu@diva.com.tw

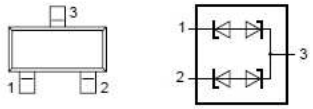
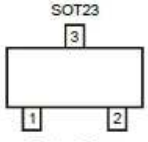
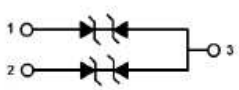
DIVA Labs.

Comparison Report

1. Package Dimension

Item	Old 3D12VL2BT1Y ESD (PESD12VL2BT_SOT-23,NXP)	New 3D12VL2BT2Y ESD (DESD12VL2BTQ,SOT-23,DIODES)
	 Dimensions in mm	 SOT23 Dim / Min / Max / Typ A 0.37 0.51 0.40 B 1.20 1.40 1.30 C 2.30 2.50 2.40 D 0.89 1.03 0.915 F 0.45 0.60 0.535 G 1.78 2.05 1.83 H 2.80 3.00 2.90 J 0.013 0.10 0.05 K 0.890 1.00 0.975 K1 0.903 1.10 1.025 L 0.45 0.61 0.55 L1 0.25 0.55 0.40 M 0.085 0.150 0.110 a 0° 8° -- All Dimensions in mm
		

2. Function table

Old 3D12VL2BT1Y	New 3D12VL2BT2Y
Pin / Description / Simplified outline / Symbol 1 cathode 1 2 cathode 2 3 double cathode 	SOT23  Bottom View  Device Schematic

DIVA Labs.

Comparison Report

3. Electrical (Ta=25°C)

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T_C = 25°C)

Parameter	Symbol	Limits		Unit
		(Old)	(New)	
Peak Power (tp=8/20μs)	P_{PP}	200	110~230	W
Operating temperature range	T_{OP}	-65 to +150	-55 to +150	°C
Storage temperature range	T_{STG}	-65 to +150	-55 to +150	°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_A = 25°C)

Parameter	Symbol	(Old)	(New)	Unit
Reverse Standoff Voltage	V_{Rwm}	12	12	V
Breakdown Voltage	V_{BR}	14.2~16.7	13.5~18.5	V
Clamping voltage	V_C	20	22	V
Capacitance	C_d	19	19	pF
Maximum Contact discharge voltage Per IEC61000-4-2		30	30	kV
Maximum Air discharge voltage Per IEC61000-4-2		30	30	kV

4. Conclusion

This component change has been evaluated by DIVA; the initial successor evaluation showed the new successor is compatible with former model. None of the other components and program will be needed to recalibrate or implement. The ECN will be provided if you approve.

鈺緯科技開發股份有限公司

設計變更審查會議記錄

會議名稱	ECN/ECR	日期	2025/12/22	時間	14:00-14:30	地點	800
會議種類	例會						
主席	Terry	與會人員	Oliver, Dennis, Ryan, Miu, Morris, Eric, Hsuan, Kevin T				
會議記錄	Terry	缺席人員	無				

主席指示事項：

No	工作項目	負責人
1.	因 Nexperia 停止供貨, 進行相關替代料功能,性能及安全性評估	Kevin Tan
2.		

決議事項：

No	工作項目	負責人	狀態
1.	EC 發行新增替代料	Kevin Tan	

追蹤事項：

No	工作項目	負責人	完成日期	狀態	
1.	無				

會議記錄內容：

設計變更原因：因 Nexperia 停止供貨, 增加替代料

設計變更描述: 新增 3BBT390602Y,3BBT390442Y, 3D12VL2BT2Y, 3DSL24PL01Y

3DBAT54009Y, 3DBAT54019Y 替代料

導入時程：Normal

客戶審查：Needed

一. 研發課評估:

單位	審查內容	附加文件
EE :	經測試比對, 功能性及外觀正常	比較表
FW:	經評估該元件與 FW 設計無關,不會造成軟體安全性影響	
ME:	經評估該元件與機構設計無干涉,不會造成安全性影響	
SW:	經評估該元件與軟體設計無關,不會造成軟體安全性影響	
DQE:	經評估該元件不會造成安規安全性影響	

二 結論:

1. 開發單位各部門評估後,此設計變更不會對產品預期用途造成影響,

功能	設計變更內容無關功能影響
性能	設計變更內容,無關產品性能影響
可用性	無影響,沒有使用上的風險
安全性	組裝方式沒有改變, 沒有安全性風險,
法規	經審查,沒有影響法規內容

2. 發行 EC

Kevin_Tan

寄件者: Terry_Huang <terry_huang@diva.com.tw>
寄件日期: 2025年12月23日星期二 上午 11:50
收件者: 'Morris_Pan'; 'Chris_Lu'; 'Judy_lu 盧柏妤'; 'Rongchi_Liao'; 'Tina_Chen 陳美玉'; '王曉雯_Sherry Wang'; 'Una_Tsai 蔡亞純 '; 'Killy_Lee'; 'Mary_Wang 王彥筑'; '黃瓊玉'; 'ericchang'; 'Alina_lee'; 'Sharon_Yeh 葉文琴'; 'Sandra 李慧珊'; 'Estela Hu 胡靜文'; 'Joan_Wang 王尹珏'; 'RD 陳凱翔 Tony Chen '; 'LaslieChen 陳志偉'; 'Lewis_Lee 李慈暉'; 'Kent_Lin林政宏'; 'Nick_Lin 林益銓'; 'MomoHsiao 蕭玉桃'; 'BowenWu 吳汶浦'; 'Shelly_Huang 黃小評'; 'Oliver_Chen 陳冠華'; 'Amber_Tsao 嘉雯'; '李金龍 Kevin_Lee '; '陳泰盛 Tyson_Chen'; 'Ben'; 'RoyHuang 黃玉樹'; '楊建勛 Michael Young'; 'Ryan_Wang 王志維'; 'kevin_Tan 譚德和'; 'RD 陳凱翔 Tony Chen '; 'Ferris_Tsai 蔡豐禧'; 'Miu_Liao'; 'Owen_Chiang'; 'Eric_Chang 張鈞凱'; Joseph_lu@diva.com.tw; danielsue@diva.com.tw; tonychen@diva.com.tw; kent_lin@diva.com.tw; kevin_peng@diva.com.tw
副本: 'Oliver_Chen 陳冠華'; kevin_chen@diva.com.tw; 'Dennis'; 'Hu, Estela (Partner)'; 'Lily_Chiu'
主旨: [1223]ECR會議紀錄

Hi ALL

本週進度

列標籤	計數 - Item
Closed	236
OPEN	49
樣品申請中	5
RD驗證中	1
EC作業中	2
待客戶確認	2
總計	**295**

- Nexperia物料標準品內部EC，三菱，CANVYS，JKC外部EC
- \\192.168.0.14\eol & ec管理空間

Item	ECR P/N	DES	
83	3FF02907510	CONN.F (DVI-I,DVIA-029G1PBB-A,SUPERIOR)	8. 比較表完成，pending，有需求再啟動EC
88	3FM00903410	MINI DB-09 (1210-004-09P-AAE,TEKCON)	7. AD BD 11-2 LTB已下單，扣除工單剩餘20
145	敏美lable	詳#145	5/19 敏美label變更影響安規加報，請Chris
160	3TFTLCD12E0	LCD MODULE (G121EAT02.0,PCAP,AUO 12.1")	12/22 RD發行EC (Daniel)
184	詳#184	EC notice for UV328-free polarizer	12/1 ADP資料已給齊，下週討論通知客人
194	3ZAD24V2511 3ZAD24V2515	ADAPTER (24V2.5A,MDS-060AAS24 BA,UKCA)	9/30 EC25091401 2515 >>> 2740 EMI對策
195	3ZTSPQP0M13	T/P (27,9AQ27009-001,AG,GIS)	8/11 TP餘料40pcs呆料
161	3ZTSPQP0M10	T/P (27,9AQ27005-001,Short FPC,AG,GIS)	12/22 Canvys 5pcs先行退料不組(LCDG27X
208	3N097091B00 3N097091W00	SILICONE GLUE (7091,DOW CORNING,BLACK) SILICONE GULE (7091,DOW CORNING,WHITE)	12/22 驗證3次fail，不進行更換

241	3FF00406910	CONN.F (8370-049-000-800,1.25mm,KYOCERA)	三菱預計下單1k ，不上件(不改BOM) 8/4 AD BD 11-2 1K 2AAD254R038 已下單，
245	上線機種LABEL確認		7/28 已確認EPIQ VM14上線機種敏美轉威嘉
248	3FM00300820	AC SOCKET (R-301SN,RICH BAY)	12/12 承認文件未交付(富灣) 12/22 確認中
249	3KH00077340	AC SOCKET(R-301SN(00))&GND WIRE,YOMIN	12/22 待富灣AC SOCKET提供一併處裡
252	3ABD4746G1Y	IC (BD4746G-TR,SMD,ROHM)	8/11 無需求pending
253	3ABA7657F1Y	IC (BA7657F-E2,SMD,ROHM)	8/11 無需求pending
267	3ZES0005010	ROTARY ENCODER (ED1115S(F))	12/12 業務希望申請專用料, 因政備20K充足 三菱26年需求200台，2AADL21R04X*3398 12/17 Daniel 發EC導入三菱專用客戶碼 12/22 Daniel 發行三階專用客戶碼
268	3AAPW71371Y	IC (APW7137,SOT23-5,ANPEC)	11/3 EETI 3188 優先決議如何處理， <已加測81H84, Eric驗證EMI> 12/12 替代料MT5080已驗證, 現已和
275	2AAD137IC01	**EETI IC ASSY (3188+5440)**	12/22 已被料1k FOR 18.5需求，PO41000
276	3AG671L001Y	**IC (G671L263T93U,SOT323,GMT)**	10/20 下政備同3188 6K訂單 11/3 同3188訂單，後續轉81H84 12/1 多下3000pcs 政備 配套3188+5440 T 12/22 無需下單
278	2AAD095R03E	DC 24/12 BD ASSY (LCRA21EAGBCXBIU)	11/24 去Canvys確認中，寄給客人2台 有 1台 12/1 整機寄回DIVA RD分析 12/22 Fail，複製還原現況找原因
279	**3BBT390601Y**	TR (PMBT3906,SOT-23,SMD,NXP)	12/17 Q2有望解禁，會有新的牌子產出，先 12/22 標準品內部EC，三菱，canvys，JKC
280	**3BBT390420Y**	TR (PMBT3904,SOT-23,SMD,NEXPERIA)	12/17 舊料穩定供料，EC待發 12/22 標準品內部EC，三菱，canvys，JKC
281	**3D12VL2BT1Y**	ESD (PESD12VL2BT_SOT-23,NXP)	12/17 Q2有望解禁，會有新的牌子產出，先 12/22 標準品內部EC，三菱，canvys，JKC
282	**3D2020EH01Y**	DIODE (PMEG2020EH,SOD123F,SMD,NXP)	12/17 Q2有望解禁，會有新的牌子產出，先 12/22 標準品內部EC，三菱，canvys，JKC
283	**3DBAT54004Y**	DIODE (BAT54C,SMD,NXP)	12/17 Q2有望解禁，會有新的牌子產出，先 12/22 標準品內部EC，三菱，canvys，JKC
284	**3DBAT54005Y**	DIODE (BAT54A,SOT23,SMD,NXP)	12/17 Q2有望解禁，會有新的牌子產出，先 12/22 標準品內部EC，三菱，canvys，JKC
285	**3DBAT54006Y**	DIODE (BAT54C,SOT23,SMD,NXP)	12/17 Q2有望解禁，會有新的牌子產出，先
286	**3DBAT54007Y**	DIODE (BAT54,SOT23,SMD,NXP)	12/17 Q2有望解禁，會有新的牌子產出，先
287	**3DBAT54008Y**	DIODE (BAT54S, SOT23, SMD, NXP)	12/17 Q2有望解禁，會有新的牌子產出，先
288	3TFTLCD21Z0	LCD MODULE (G215HAN01.2,AUO 21.5")	11/3 待廠商提供樣品，TBD，是否於請產線